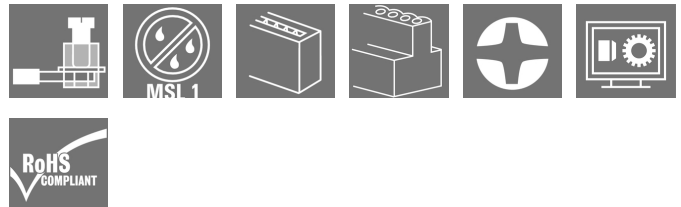


**OMNIMATE Housing - Serie CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Il mondo dell'elettronica in un disco.**

In appena 6,1 mm di larghezza grazie al know-how degli sviluppatori elettronici possono nascere dei piccoli mondi applicativi.

Il concetto di custodia modulare supporta il settore dell'engineering con una serie di caratteristiche intelligenti:

- **Massima libertà di progettazione** grazie alla superficie netta (6800 mm²) disponibile sul circuito stampato per il massimo equipaggiamento attraverso le geometrie ridotte dei connettori maschio THR reflow compatibili
- **Possibilità di design personalizzato** grazie alla siglatura e alle opzioni cromatiche della custodia, ma anche al coperchio orientabile e personalizzabile, siglabile in diversi modi con facilità
- **Massima efficienza** durante la lavorazione di elementi di collegamento reflow compatibili confezionati su nastro per tutti i processi di siglatura
- **Processi di equipaggiamento e saldatura senza errori** grazie alle geometrie ottimizzate del telaio per il circuito stampato e alle geometrie di appoggio per un corretto posizionamento degli elementi di collegamento
- **Installazione rapida** grazie a funzioni come "Wire ready", o la testa della vite Multi-Tool universale

Il know-how degli sviluppatori elettronici e la competenza Weidmüller - un team innovativo e di successo il cui obiettivo principale è quello di dare vita ad applicazioni elettroniche.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LHZ-SMT L 1.5SN BK RL
Nr.Cat.	2418580000
Versione	Morsetti per circuito stampato, Elemento di collegamento sinistro, Blocco progettare, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, Numero di poli: 1, Lunghezza spina a saldare (!): 1.5 mm, stagnato, Nero, Tape
GTIN (EAN)	4032248984350
CPZ	432 Pezzo
Parametri prodotto	IEC: 500 V / 0.2 - 2.5 mm ² UL:
Imballaggio	Tape

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	23,5 mm	Lunghezza (pollici)	0,925 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0,236 inch
Posizione verticale	16,9 mm	Altezza (pollici)	0,665 inch
Peso netto	3,32 g		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento di collegamento sinistro	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Numero di collegamenti	1	Spessore circuito stampato	0,8 mm
Lunghezza spina a saldare (l)	1,5 mm	Tipo di contatto per circuito stampato	Reflow
Contatto con guida di supporto	No	Grado di protezione	IP20

Dati del materiale

Materiale isolante	LCP	Colori	Nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	IIIa
CTI	≥ 175	Resistenza contro l'isolamento	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Superficie dei contatti	stagnato	Temperatura di magazzinaggio, min.	-25 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	55 °C	Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %
Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio, max.	120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	120 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	13 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40 °C)	13 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	500 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	320 V	Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	4 kV	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	4 kV		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002643
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-04-01
eClass 9.1	27-44-04-01		

Note

Note	
Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Dati ingegneristici

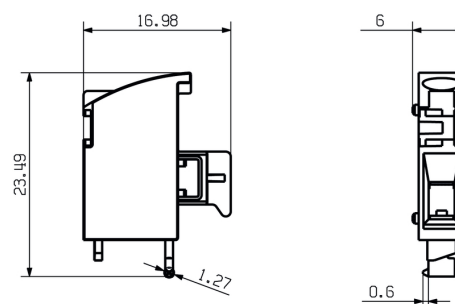
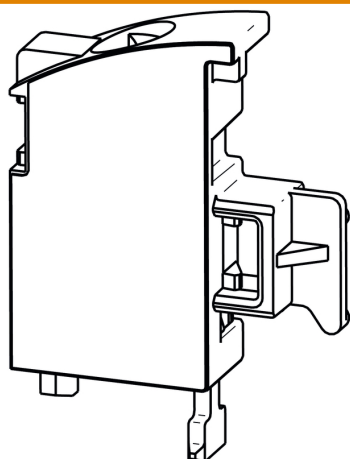
[EPLAN, WSCAD](#)

Dati ingegneristici

[STEP](#)

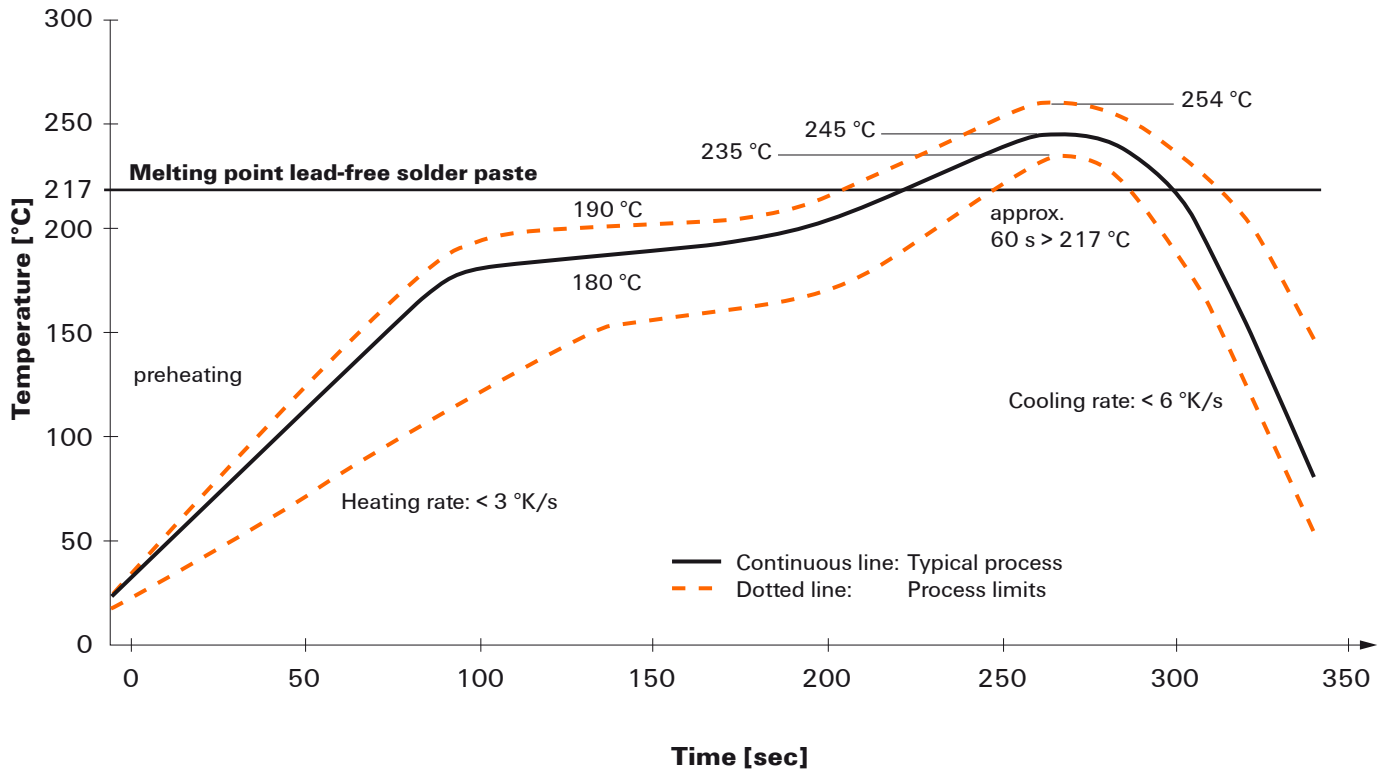
**OMNIMATE Housing - Serie CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.